

超音波接合の優位性

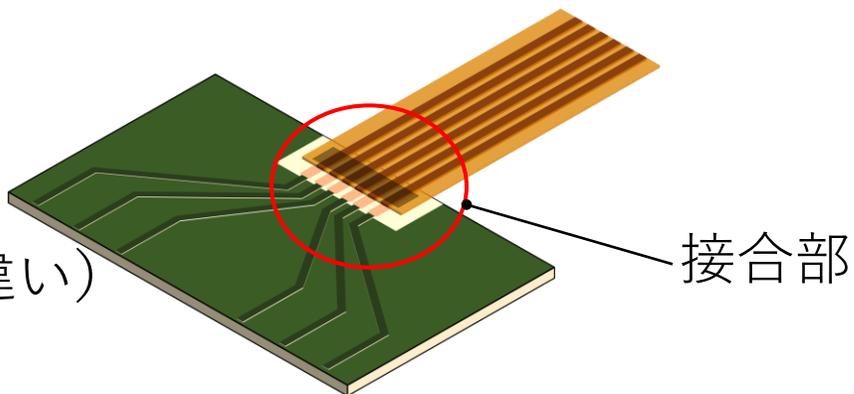
- 低抵抗接合：ダイレクト接合のため**低抵抗※**
- 短時間接合：**1秒以下**で接合
- 常温接合：基板の**熱膨張なし**

※【TEG 接続抵抗の平均値比較】

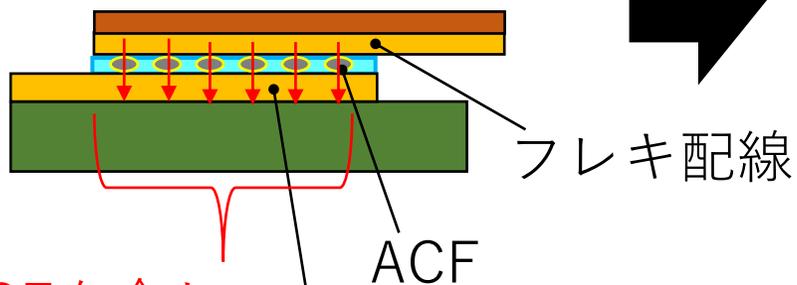
- ・超音波接合 : **14mΩ**
 - ・ACF 接続 : 52mΩ
- 72%低減**

フレキシブル基板超音波接合

接合メカニズム（接合部の違い）



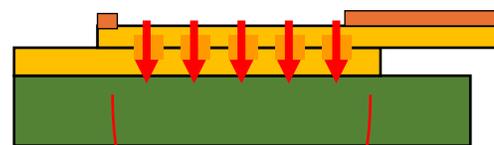
従来工法（ACFの例）



ACFを介して
の接触接続
→抵抗高い

リジット基板電極

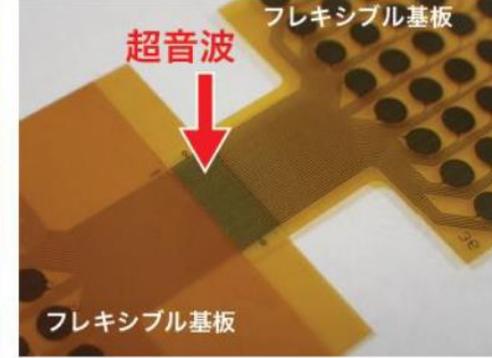
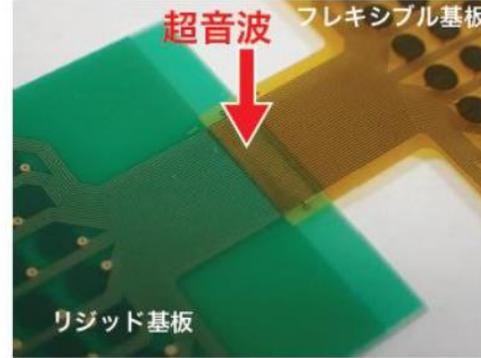
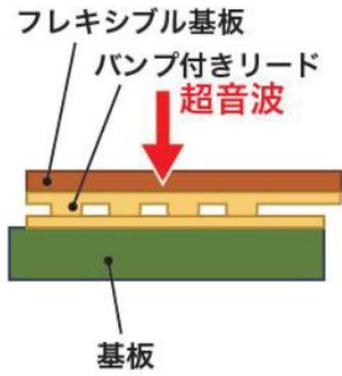
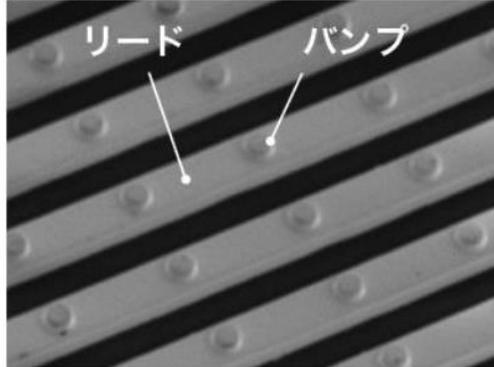
超音波接合技術



金属同士が原子レベルで
ダイレクトに接合
→低抵抗で電氣的接続が可能

接合バリエーション

●バンプリード



●フライングリード

